

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当登陆www.szse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

- 2.重大风险提示:公司已在本报告中详细论述了在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4.公司全体董事出席董事会会议。
5.信会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6.公司上市以来未发生利润分配。
[是] √ 否
7.董事会审议通过2023年度利润分配预案或公积金转增股本预案
8.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》,为更好推动公司后续发展的稳定经营,我们将回报小投资者的,在充分考虑保障日常经营及发展规划所需资金的前提下,公司2023年度度拟向全体股东每10股派发现金红利1.86元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本80,629,354股,以此计算合计拟派发现金红利15007.05万元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
本利润分配除尚需2023年度股东大会审议。
8.是否存有关公司治理特殊安排等重要事项
[适用] √ 不适用

第二节 公司基本情况

- 1.公司简介
(1)股票简称:方邦股份
(2)股票代码:688020
(3)上市地:深圳证券交易所创业板
(4)上市日期:2022年12月16日
(5)注册地址:广州市南沙区东涌镇广和路30号
(6)办公地址:广州市南沙区东涌镇广和路30号
(7)电话:020-46611661
(8)电子邮箱:gf@fzq.com.cn
(9)网站:www.fzq.com.cn
(10)信息披露方式:深圳证券交易所指定信息披露网站(巨潮资讯网)
(11)联系人及联系方式

Table with columns: 联系人姓名, 职位, 电话, 电子邮箱, 联系地址, 是否为披露联系人

2.报告期主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
1.主要业务:公司主营业务为高端电子产品的研发、生产及销售,专注于提供高端电子材料及应用解决方案,现有产品主要是电磁屏蔽膜、各类铜箔、挠性覆铜板、电阻铜箔、复合铜箔等。
2.主要产品或服务情况
(1)电磁屏蔽膜:电磁屏蔽膜是一种在微米级别,具有复杂结构,具有抑制电子元件电磁干扰的功能,通过贴合于PCB生产用。现代电子产品“轻薄短小”和高频高速化趋势更加明显,驱动着电子元件器件以及组件内外部的电磁干扰,以及信号在传输中频频出现断步,对电磁屏蔽的需求更大,同时也提出了更严苛的要求。

公司的电磁屏蔽膜主要可分为HSP/US38B和HSP-US38B两大类。其中HSP-US38B系列是2014年推出的新型电磁屏蔽膜,具有自主研发的獨特材料结构,屏蔽效能进一步提高,同时大幅降低信号传输损耗,降低传输信号的完整性。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断,目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端品牌产品。
(2)铜箔产品:报告期内,公司铜箔产品主要包括带载体铜箔可剥离超薄铜箔(以下简称“可剥离”),各类电子铜箔。带载体铜箔可剥离超薄铜箔是制备芯片封装基板(IC载板、美基板、HDI板)所需材料。目前IC载板、美基板蚀刻线宽已超10/10μm~40/40μm,用传统的铜箔加工工艺制造铜箔,必须使用mSAP(半固化工艺),而mSAP必须使用可剥离。公司生产的可剥离具有厚度极薄、表面粗糙度低、载体铜箔和可剥离层之间的分离力稳定可控等特点,可满足mSAP的兼容性要求。

3.挠性覆铜板:挠性覆铜板(CCL),挠性覆铜板(PCCL),印制电路板(PCB),柔性线路板(FPC)的主要基材。主要有高频高速材料、高频材料、传统材料、多层材料、高频材料、抗热处理覆铜板(RTF)、主要用于高频高速和低频材料覆铜板(VLP),主要用于高频高速、低频材料覆铜板等。公司生产的各电子铜箔、厚度、延伸性、而密度、耐粘性、表面粗糙度等指标均满足客户要求。
(3)弹性覆铜板:弹性覆铜板(FOCL)是FPC的加工基材,由弹性体基材和金属材料制成,具备独特结构,挠性覆铜板可分为有胶正电阻覆铜板(3L-FOCL)和无胶两层弹性覆铜板(2L-FOCL);根据产品厚度的,每类弹性覆铜板又分为普通型和超薄型。
下游电子产品快速发展,推动PCB制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破,从而对FPC的高度互连(HDI)技术要求也不断提高。PCCL是实现高密度互连技术的关键材料之一,可大幅提高电子元件封装密度并节约封装成本,并可实现线路板PCB制造,公司采用自主研发原料材料,主要是RTF铜箔和PTPI的工艺技术经生产PCCL,可降低生产成本,同时实现其铜层厚度和表面粗糙度、电性能、耐热特性以及尺寸稳定性等关键指标满足下游需求,具有良好的加工性能。

1.采购模式:公司采用“以产定购、批量订购”的采购模式,由采购人员根据各个品种库存和生产计划期间以及库存情况,确定每个品种的订购批量进行发出打货需求单。公司的采购体系实行ISO9000生产,采购价经协商一致方式主要采用竞价模式。
2.生产模式:公司采用“以销定产、提前预想相结合”的生产模式,由市场部接到客户订单或需求后向生产部门下达生产指标,生产部门根据订单规格及库存情况安排相应的生产计划。
公司的电磁屏蔽膜的生产环节包括表面处理及表面处理、电解涂布、金属合金化处理、微纳坑金属形成、导电线路涂布等,铜箔生产环节分为卷箔、生产、后处理等。弹性覆铜板的生产核心环节包括金属成膜、涂布、真空烘烤、压合等,公司产品的为高端电子材料,生产工艺复杂,技术含量高,为有效控制产品质量,PCB的涂布和烘烤工艺,漆膜厚度,涂布精度等,上述生产环节均由公司自主完成,不存在任何外包的业务模式。公司产品的原材料采购严格执行合格管控,在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程全过程进行监测,并对最终产品进行质量检验。
3.销售模式:报告期内,公司的销售模式为直销模式,直接客户为线路板厂商和覆铜板厂商,最终用户为智能手机、平板电脑以及汽车等行业厂商。公司一方面积极市场调研,行业动态趋势、技术进步等情况,自行针对目标市场进行产品开发,为下游客户提出解决方案;另一方面,公司和下游客户以及终端品牌厂商建立了良好的合作关系,形成了粘性互动。公司根据下游客户的需求进行针对性的产品开发和管理。
产品开发完成一致,由下游客户进行打样,工艺验证和基本性能测试,通过后由封装终端品牌厂商进行性能优化测试,之后通过小量试产,验证产品的稳定性后即进入终端产品的物料采购,待相关商务条款达成一致,方可批量生产、销售。

公司长期坚持以自主创新、采用定制化研发和自主定制化研发相结合的方式。在定制化研发方面,通过与下游线路板厂商的交流合作,了解下游客户对电磁屏蔽膜、超薄铜箔、挠性覆铜板等产品的个性化需求,进行定制化研发。在自主定制化研发方面,采用自主研发的方式,依据自身积累的经验,根据市场需求,设计产品,生产部门配合实验室进行测试确认,不断优化实验方案,不断研发,最终确定,最终确定后进行小批试生产,试产合格后再进行大批量生产,逐步提升现有产品的性能。
(三)所处行业状况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
(1)所处行业:公司主要从事为高端电子材料的研究、生产及销售,根据国民经济行业分类与代码(CGB17474-2017),公司所处行业属于“C3885电子专用材料制造”。
(2)行业发展阶段及基本特点:电子专用材料制造行业是支撑国民经济和国家安全的战略性、基础性和先导性产业,其发展程度是一个国家科技发展水平的重要标志之一。电子专用材料制造行业,将导致其下游产业如芯片封装、集成电路等精密制造密切相关的关键的G半导体、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域继续依赖进口原材料,成为“卡脖子”困境。近年,国家深入实施“一核两翼双链”工程,将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一,大力支持其发展。2018年颁布的《战略性新兴产业分类(2015)》,明确将“电磁屏蔽膜”、“高频高速、高密度互连铜箔”、“PCB用铜箔”属于电子专用材料为重点产品。
报告期内,公司产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔,直接下游客户为线路板(PCB)厂商、覆铜板厂商,应用领域广泛主要为消费电子,部分应用于汽车行业。
PCB为“电子产品之母”之称,能实现电子元件的相互连接,承担中继传输作用。近年来,随着5G通信、消费电子、汽车电子等行业的发展,PCB市场规模逐年扩大,根据Prismark(高工研(GII))等行业统计,2023年全球PCB行业总收入达804亿美元。然,受全球经济下行、消费电子疲软等因素影响,PCB的市场需求在2022年有所弱复苏,全球PCB行业呈现震荡下行、消费电子需求疲软,PC、手机、电视等终端受到较大影响,预计2022年全球PCB行业市场规模同比下滑15.0%,同时,需求疲软使得价格压力令全产业链面临严峻挑战,行业水平下降。
然而,与IT消费电子不同,C/HATGP/T引线的15.0T,人工智能及算力需求,AI、PC/AI服务器及AI终端世界的新一轮消费电子产品的新需求和结构,以及碳中和背景下新能源汽车产业及汽车电子化、智能化和网络化的快速发展,预计将在未来成为PCB行业带来新一轮成长机遇。根据Prismark预测,2022年至2027年全球PCB复合增长率3.8%,2022年全球产值将达到983.88亿美元;2022年至2027年中国PCB复合增长率为3.3%,2022年产值将达到511.33亿美元。
另一方面,回顾整个PCB发展历程,全球PCB产业初期由美国国家厂商主导,随着电子PCB产业发展壮大,形成了欧美日共同主导的局面,进入21世纪后,亚洲地区由于具有劳动力成本优势,同时IT消费电子终端产业发展欣欣向荣,能够为PCB提供巨大的市场需求支持,因此吸引了众多全球PCB厂商的投资,欧美PCB产业大量转移到亚洲地区。
随着技术进步,亚洲市场快速增长,亚洲市场主要全球PCB产业,目前形成了以亚洲为主的“先光后铜箔”格局。
PCB行业在总体量不断增强的同时,还呈现出现代不断提升的特点,表现为高频板(FPC)、高密度互连板(HDI)、芯片封装需求等高性能电磁屏蔽需求持续增强,同时围绕AI无源元件的市场需求也在逐步显现,据Prismark统计及预测,全球FPC、HDI和封装基板2023-2028年的复合增长率分别为4.4%、6.2%和8.8%,至2028年三者产值分别为151.7亿美元、142.26亿美元和139.05亿美元。

全球PCB产业、技术路线整体上呈上升趋势,增大了对公司电磁屏蔽膜、弹性覆铜板、超薄铜箔以及电阻铜箔产品的市场需求。总体来看,电子专用材料市场规模广阔,我国高端电子专用材料自给率仍较低,具有很大的发展空间。
(3)主要技术门槛:首先,公司长期深耕消费电子产业链,以电磁屏蔽膜产品为抓手,与华为、三星等世界顶尖企业建立了长期稳定的深层次技术交流渠道和机制,可第一时间掌握5G通讯、芯片封装、超薄显示等关键行业最新的技术发展及趋势。
其次,公司拥有上述技术发展基础及需求快速提供相应产品及解决方案的獨特能力,这种能力源自于公司自主开发的精准激光照射、精密涂布、连续卷绕电镀以及高精度树脂合成及配方等四大基础技术,并采用先进技术团队合作创新,这让公司在专用材料制造中拥有很强的优势。
原因在:将导电材料与绝缘材料进行结合,形成高性能复合材料,这是制备高端电子产品的底层技术路径。一方面,通过自主开发的真空喷射、连续卷绕电镀技术,公司可生产各种高纯度的金属箔,如超薄铜箔、标准铜箔等,其厚薄、粗糙度以及表面形貌可定制;另一方面,通过精密涂布以及特殊配方技术,公司可生产绝缘薄膜,例如PI、PTPI以及PTFPE等,改性环氧树脂、丙烯酸树脂等。具备上述基础后,通过将金属箔与绝缘膜进行搭配组合,可生产各种功能的高端电子材料(薄膜),如箔铜搭配PI/PII,制备薄柔性覆铜板以及特殊结构的复合金属箔、电阻薄膜等,从而快速、定制化满足下游终端的最新业务需求。电子专用材料的研发及制造是一个复杂的系统工程,涉及原材料和生产、工艺、品质控制等诸多方面,而自主定制材料产品呈现出其系统,需要一方面具备电磁屏蔽膜产品的增加,另一方面逐步实现设备设施转型升级,随着技术不断进步,产品升级难度不断提升,不具备一定技术实力、研发技术储备及行业经验的企业无法适应市场的需要。
目前公司主要产品关键技术点及技术壁垒如下:
电磁屏蔽膜:屏蔽效能≥60dB,接地电阻≤200mΩ,同时满足载插插入损耗、翘层、耐弯折、耐折弯、耐老化等苛刻加工应用要求;
挠性覆铜板:铜箔厚度2-9μm,12/18/35μm(可定制化),剥离强度≥10N/cm,尺寸稳定性(%)≤±0.08,同时满足耐热固化等苛刻加工应用要求;
带载体铜箔超薄铜箔:主要特点为厚度超薄、表面粗糙度低、铜层厚度1.5-6μm、铜层粗糙度0.5-20μm,剥离强度≥6N/cm,拉伸强度≥2000mm/2mm,伸长率≥5%;
标准铜箔:铜箔厚度12-35μm为W,可定制化,延伸性、表面密度、表面粗糙度等符合客户要求;
2.公司所处行业产业链分析及其竞争优势
(1)公司在产业链中的地位:公司产品在产业链中,满足提供基本本土化在电磁屏蔽膜领域,公司具有重大的市场、行业地位,市场占有率较高。公司的电磁屏蔽膜产品填补了在高端电磁屏蔽领域的空白,打破了国外企业的垄断。
在弹性覆铜板领域,其主要原材料为铜箔、聚氨酯(TPI)和热塑性聚氨酯(PTPI),公司采取自主研发原料材料的策略来生产弹性覆铜板,以逐步打破对国外上游优质资源的依赖,建立核心竞争优势和技术壁垒,大幅提升生产效率,提升产品市场竞争力和经济效益。另一方面,制备薄柔性覆铜板等高端产品,对铜箔厚度、粗糙度以及产率要求很高,公司拥有先进的技术、工艺和配方可满足以上技术需求。对于薄柔性覆铜板领域,目前市场上全球量产供应商主要为日本的东丽和住友,公司自主研发的超薄柔性覆铜板,其铜箔厚度和表面粗糙度、电性能、耐热特性以及尺寸稳定性等关键指标均先进,具有优异的加工性能。
在超薄铜箔领域,公司生产的带载体铜箔可剥离超薄铜箔,目前该产品全球量产供应商主要为日本的三井物产自主研发生产的超薄铜箔,其铜箔厚度、电性能、耐热特性、抗拉强度等关键指标均处于世界先进水平。
(2)公司产品覆盖行业内众多知名客户并建立了稳定的合作关系
凭借良好的产品质量、持续的技术创新和快速的售后服务,公司产品赢得了鹏辉、MFLX、弘信、景旺、BHE等众多优质投资客户,并先后与小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端客户保持密切的技术交流与合作。
3.报告期内新技术、新产品、新业态、新模式的发展情况和未来发展态势
(1)电磁屏蔽膜:电磁屏蔽膜受益于5G-5.5G通讯、人工智能、汽车电子、虚拟现实技术等行业的快速发展。5G-5.5G环境下,以智能手机为代表的AR/VR硬件设备为驱动的消费电子产品“轻薄短小”,高频高速化趋势愈加明显,其内部线路板PCB使用频率增加以提升内部装置效率,同时电子元件器件之间的电磁干扰亦随之加剧,这客观上加大了对于电磁屏蔽膜的需求,这种需求一方面使得电磁屏蔽膜产品的增加,另一方面逐步实现设备设施转型升级,随着技术不断进步,产品升级难度不断提升,不具备一定技术实力、研发技术储备及行业经验的企业无法适应市场的需要。
(2)铜箔产品:随着AI手机/AI手机等消费电子产品的需求,折叠手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折、AI手机电池、HDI板,超高层PCB,2024年AI手机整机出货量上看1.7亿支,占整体手机比重近15%,AI手机的高频及高速率传输的刚需特性,要求电磁屏蔽膜在车载功能方面承接起更大的责任。
在国内“双碳战略、碳中和”目标提出之后,我国新能源汽车推广普及进程加快,新能源汽车智能化的特别明显,随着汽车向电动化、智能化发展,FPC在弯折性、减重、自动化程度高等方面的优势进一步体现,

2023 年度报告摘要

证券代码:688020 证券简称:方邦股份 公告编号:2024-017
广州方邦电子股份有限公司 董事会 2024年4月16日

广州方邦电子股份有限公司 2023年度利润分配预案公告

公司本次利润分配预案:1.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
2.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
3.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
4.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
5.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
6.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
7.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
8.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
9.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
10.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
11.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
12.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
13.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
14.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
15.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
16.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
17.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
18.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
19.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
20.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
21.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
22.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
23.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
24.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
25.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
26.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
27.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
28.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
29.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
30.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
31.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
32.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
33.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
34.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
35.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
36.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
37.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
38.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
39.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
40.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
41.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
42.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
43.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
44.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
45.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
46.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
47.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
48.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
49.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
50.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
51.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
52.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
53.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
54.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
55.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
56.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
57.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
58.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
59.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
60.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
61.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
62.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
63.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
64.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
65.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
66.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
67.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
68.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
69.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
70.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
71.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
72.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
73.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
74.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
75.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
76.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
77.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
78.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
79.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
80.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
81.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
82.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
83.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
84.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
85.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
86.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
87.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
88.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
89.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
90.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
91.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
92.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
93.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
94.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
95.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
96.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
97.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
98.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
99.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
100.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
101.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
102.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
103.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
104.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
105.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
106.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
107.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
108.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
109.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
110.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
111.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
112.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
113.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
114.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
115.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
116.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
117.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
118.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本80,629,354股为基数,拟派发现金红利1.86元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。
119.2023年度利润分配预案:以截至2023年12月31日公司总股本